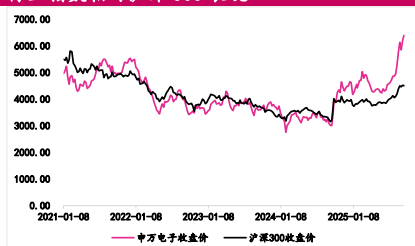


电子行业

2025 年 11 月 2 日

涨幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
本川智能	57.69	27.50	44.59
生益电子	108.80	22.33	905.02
信维通信	35.77	21.17	346.10
大为股份	28.02	20.52	66.53
绿联科技	71.15	19.92	295.21
跌幅 TOP5	最新	周涨跌幅	总市值
思泉新材	183.53	-20.89	148.21
灿芯股份	116.78	-20.01	140.14
晶晨股份	86.00	-12.83	362.15
海能实业	12.48	-12.73	39.12
恒玄科技	246.00	-12.31	414.99

行业指数相对沪深 300 表现



相关报告

【金元电子】周报 20250921HBM 高需求或抢占平面 DRAM 产能，供需错配致使存储涨价

【金元电子】周报 20250928 云栖大会看点多，硬件+平台开放助力国产 AI 芯片及模型落地

【金元电子】周报 20251012AMD 与 OPENAI 达成 6GW 协议，开发互连技术 UALink 或加速渗透

【金元电子】周报 20251019 英伟达发布 800VDC 白皮书，“功率墙”应予以重视

【金元电子】周报 20251026 谷歌将量子优势的概念从随机任务推进到可重复验证、具备应用潜力的新阶段

分析师：唐仁杰

执业证书编号：S0370524080002

电话：0755-83025184

邮箱：tangr.j@jyzq.cn

行业周度点评报告

—三季度电子行业整体维持高景气度，AI 需求+国产替代逻辑依然不变

评级：增持（维持）

- **全行业：**本周上证指数上涨0.11%，深证成指上涨0.67%，沪深300指数下跌0.43%，申万电子板块下降1.65%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为28/31。板块个股涨幅前五名分别为：本川智能、生益电子、信维通信、大为股份、绿联科技；跌幅前五名分别为：思泉新材、灿芯股份、晶晨股份、海能实业、恒玄科技。
- **电子行业：**电子行业整体表现分化明显，板块涨跌互现。从申万二级行业数据来看，消费电子与其他电子表现较强，而半导体板块跌幅居前。具体来看：消费电子板块上涨1.19%，成为唯一明显上涨的板块，其中消费电子零部件及组装子板块涨幅1.32%，表现亮眼；其他电子板块小幅上涨0.66%，整体保持稳健。元件板块微涨 0.06%，涨幅有限，其中印制电路板子板块上涨0.55%，液动元件下跌2.10%。电子化学品板块整体下跌0.99%，子板块表现一致。光学光电子板块微跌0.22%，其中光学元件上涨0.20%，而LED子板块下跌2.30%。半导体板块表现最弱，整体下跌3.69%，细分领域中数字芯片设计子板块跌幅最大，达到4.80%，模拟芯片设计与半导体材料亦分别下跌2.75%和1.34%，拖累板块整体表现。总体来看，本周电子行业内部分化显著，消费电子板块延续强势，而半导体与光学光电子板块承压明显，行业整体呈现结构性分化格局。
- **行业要闻**
 - ◆ 应用材料削减4%人力，因应中美贸易战与营收压力
 - ◆ 台积电熊本二厂动工：主攻6nm制程，2027年底投产
 - ◆ 软银批准对OpenAI 剩余225亿美元投资，铺路IPO
 - ◆ 英特尔新AI PC处理器催动换机潮带动代工业绩
 - ◆ 微软 Win11将强化AI功能，迈向AI原生操作系统
- **公司动态：**
 - ◆ 影石创新：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
 - ◆ 蓝特光学：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
 - ◆ 奥海科技：关于2025年前三季度利润分配方案的公告
 - ◆ 四会富仕：关于控股股东及一致行动人被动稀释及减持触及1%整数倍的公告
 - ◆ 国瓷材料：关于对外投资购买股权投资基金及合作的公告
- **投资建议：**我们认为，三季度电子行业整体维持高景气度，AI 需求+国产替代逻辑依然不变。关注：1、AI 应用有望带动消费电子在 AI 手机、可穿戴与 AI PC 驱动下结构性修复机会；并且，AI 应用落地在消费端主要体现在端侧产品，国内端侧 AI 布局较早，或能够创造新一轮增量；2、汽车电子与功率器件的国产替代需求仍然较高；虽然功率半导体及分立器件市场规模未出现明显变化，但是国内功率厂商的国产替代空间广阔；3、国产算力芯片持续突破及存储厂商扩产带来 Capex 增量，国产设备有望在新一轮扩产周期内实现替代。相关公司包括：1、端侧 AI：立讯精密、瑞芯微、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微等；2、PCB 及材料：生益科技、深南电路、沪电股份等；3、功率及分立器件：扬杰科技、芯联集成等；4、半导体设备：拓荆科技、盛美上海、北方华创等。
- **风险提示：** 1、国内AI应用落地不及预期：当前AI相关产品主要通过手机、平板等3C产品落地，若相关产品销售不及预期，或导致相关公司业绩不及预期；2、半导体周期性风险：由于半导体行业周期属性强，扩产周期受供需影响，或导致设备投入及Capex不及预期；3、产品导入风险：汽车电子验证、导入周期较长，或导致相关公司业绩不及预期。

目录

一、核心观点3

二、行业跟踪6

三、行业新闻8

四、公司公告14

五、下周重要事件提示18

图表目录

图 1：细分行业 25Q3 单季度归母净利润同比/环比3

图 2：新能源汽车销量维持高增，其中 8-15 万车型维持 80%以上增长4

图 3：HBM 抢占产能+推理侧需求致使平面 DRAM 价格持续上行4

图 4：本周各行业板块涨跌幅6

图 5：本周电子板块：子板块涨跌幅7

图 6：电子板块历史走势8

图 7：电子板块历史市盈率8

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名6

表 2：本周电子板块个股跌幅前五名6

表 3：下周重要会议18

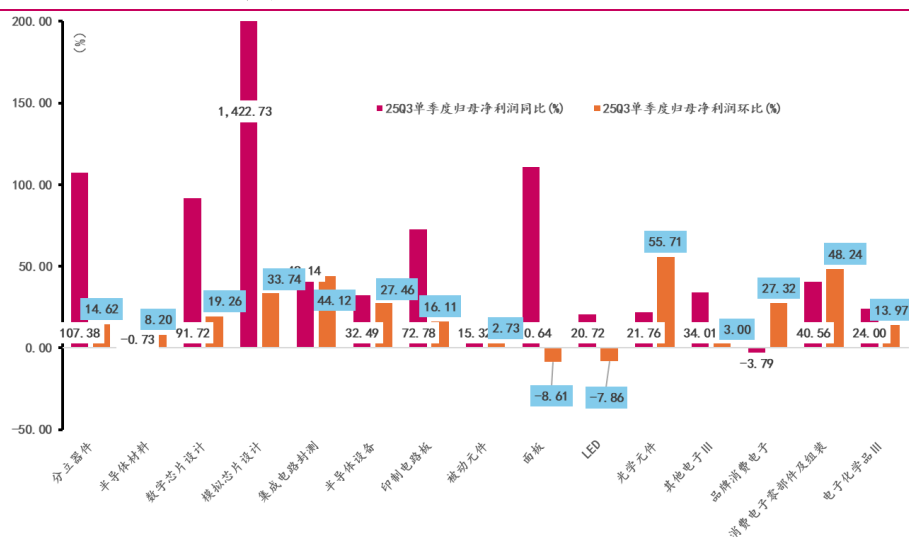
表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）19

一、核心观点

在人工智能及国产替代推动下,电子行业三季度整体表现较优。截至 10 月 31 日,除中芯国际及华虹公司未披露三季报外,电子行业 489 家上市公司已完成披露。整体来看,电子行业 25Q3 单季度实现扣非归母净利润约 516.27 亿元,可比口径下同比增长 43.67%,环比增长 144.60%。其中,77.5%的上市公司 Q3 单季度实现营收同比增长,62.4%公司实现利润同比增长。

利润贡献集中在消费电子零部件及组装、PCB、数字芯片设计、半导体设备等链条。面板在低基数与涨价驱动下修复。品牌消费电子、模拟芯片设计、LED、部分材料与晶圆制造则呈现利润承压或亏损收窄的分化格局。AI 硬件业绩持续上行,工业富联三季度实现扣非归母净利润 99.89 亿元位居首位,单季度同比增长 61.11%,较 Q2 单季度增长 95.39%。此外,随着高端 GPU/ASIC 等 AI 加速器对高层板、高密度布线需求以及新能源车、光纤通信等应用领域带动,PCB 价值量占比持续提升,PCB 龙头如沪电股份、胜宏科技、生益科技均实现较大程度增长。

图 1: 细分行业 25Q3 单季度归母净利润同比/环比



数据来源: Wind, 金元证券研究所

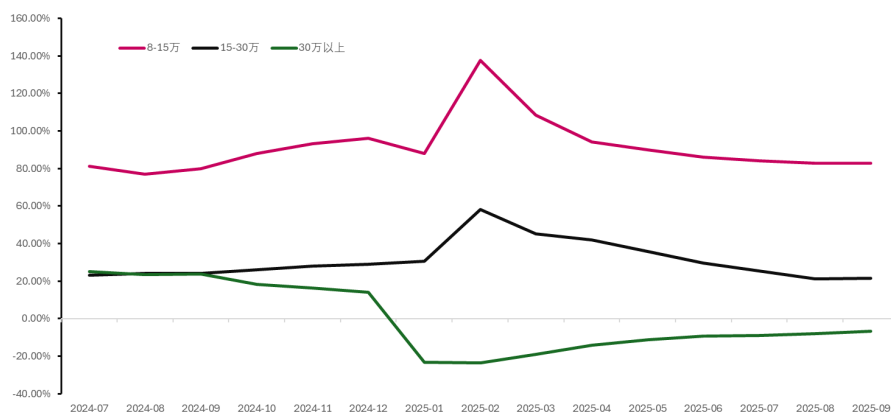
注: 为清楚展示表格并剔除极值, 图中纵坐标未完整展现

同时,随着国产替代及 AI 芯片自主可控趋势加速,云端和边缘 AI 芯片需求大增。AI 芯片设计行业方面,全志科技、炬芯科技、复旦微电、芯原股份、恒玄科技、海光信息、星宸科技、恒烁股份等实现同比、环比双增长。推理侧 AI 芯片龙头寒武纪-U 25Q3 实现扣非净利润 5.06 亿元,单季度净利润增长 390.23%,环比略降。此外,值得关注的是,AI 端侧加速应用落地,部分上市公司 Q3 季度业绩报喜。

除 AI 芯片国产替代逻辑外,国内新能源汽车销量持续走高,国产汽车电子及相关产业链加速实现国产替代,抢占市场份额。根据中国汽车业协会数据,我国 1-9 月份新能源汽车销量维持高增,其中 8-15 万车型销量维持 80%以上

的增长。8-15 万新能源车 1-9 月累计销量达 336.40 万辆，同比增长 82.93%。此外，在新能源车高压动力系统（如 800V）、充电桩拉动 SiC、GaN 等第三代半导体渗透至分立功率器件及模块，带动相关上市公司业绩改善。模拟芯片亦如此，虽然手机、平板、电脑销量未出现明显增长，但是国内模拟电子厂商份额较低，随着国内厂商份额提升带动相关上市公司业绩增长。

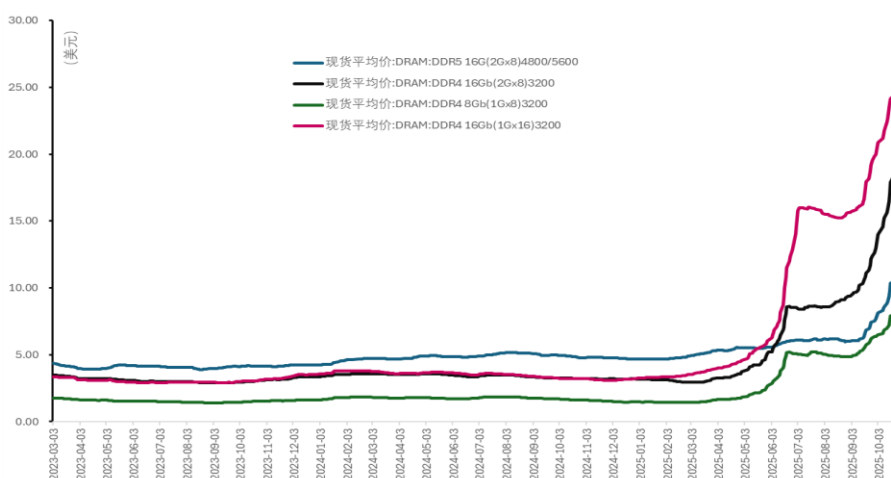
图 2：新能源汽车销量维持高增，其中 8-15 万车型维持 80%以上增长



数据来源：Wind，金元证券研究所

存储业绩出现拐点，多数个股 Q3 单季度环比大增。我们此前周报提到，在高端 AI 加速器推动下，海外存储龙头急于抢占 HBM 市场份额，而 HBM 产能挤占平面 DRAM，导致平面 DRAM 供需错配。此外，多数厂商停产 DDR4 并转向 DDR5，在此期间导致 DDR4 价格暴涨，甚至出现 DDR4 与 DDR5 价格倒挂，带动整体价格上行。另一方面，随着 AI 应用扩张，推理侧需求持续增长，高通亦推出近存架构，以满足推理机柜需求。高内存容量、高带宽、低成本、低功耗要求致使需求侧加速放量。

图 3：HBM 抢占产能+推理侧需求致使平面 DRAM 价格持续上行



数据来源：Wind，金元证券研究所

我们认为，三季度电子行业整体维持高景气度，AI 需求+国产替代逻辑依然不变。关注：1、AI 应用有望带动消费电子在 AI 手机、可穿戴与 AIPC 驱动下结构性修复机会；并且，AI 应用落地在消费端主要体现在端侧产品，国内端侧 AI 布局较早，或能够创造新一轮增量；2、汽车电子与功率器件的国产替代需求仍然较高；虽然功率半导体及分立器件市场规模未出现明显变化，但是国内功率厂商的国产替代空间广阔；3、国产算力芯片持续突破及存储厂商扩产带来 Capex 增量，国产设备有望在新一轮扩产周期内实现替代。

相关公司包括：

- 1、端侧 AI：立讯精密、瑞芯微、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微等
- 2、PCB 及材料：生益科技、深南电路、沪电股份等
- 3、功率及分立器件：扬杰科技、芯联集成等
- 4、半导体设备：拓荆科技、盛美上海、北方华创等

风险提示：

- 1、国内 AI 应用落地不及预期

当前 AI 相关产品主要通过手机、平板等 3C 产品落地，若相关产品销售不及预期，或导致相关公司业绩不及预期

- 2、半导体周期性风险

由于半导体行业周期属性强，扩产周期受供需影响，或导致设备投入及 Capex 不及预期；

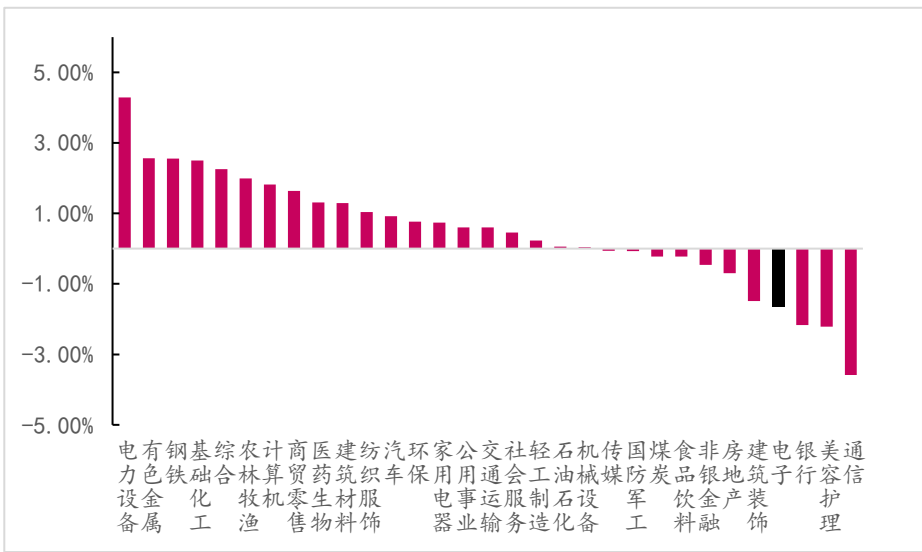
- 3、产品导入风险

汽车电子验证、导入周期较长，或导致相关公司业绩不及预期。

二、行业跟踪

全行业：本周（2025. 10. 27-2025. 10. 31）本周上证指数上涨 0. 11%，深证成指上涨 0. 67%，沪深 300 指数下跌 0. 43%，申万电子版块下降 1. 65%，电子行业在全行业中的涨跌幅排名为 28/31。板块个股涨幅前五名分别为：本川智能、生益电子、信维通信、大为股份、绿联科技；跌幅前五名分别为：思泉新材、灿芯股份、晶晨股份、海能实业、恒玄科技。

图 4：本周各行业板块涨跌幅



数据来源：Choice，金元证券研究所

表 1：本周电子板块个股涨幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
300964. SZ	本川智能	27. 50	57. 69	45. 13	59. 50	78. 41	43. 17	23. 63
688183. SH	生益电子	22. 33	108. 80	93. 59	122. 00	23. 88	198. 62	210. 96
300136. SZ	信维通信	21. 17	35. 77	29. 64	37. 28	62. 31	513. 82	170. 82
002213. SZ	大为股份	20. 52	28. 02	25. 26	29. 41	177. 19	366. 24	100. 81
301606. SZ	绿联科技	19. 92	71. 15	62. 53	74. 98	15. 29	33. 50	23. 29

数据来源：Choice，金元证券研究所

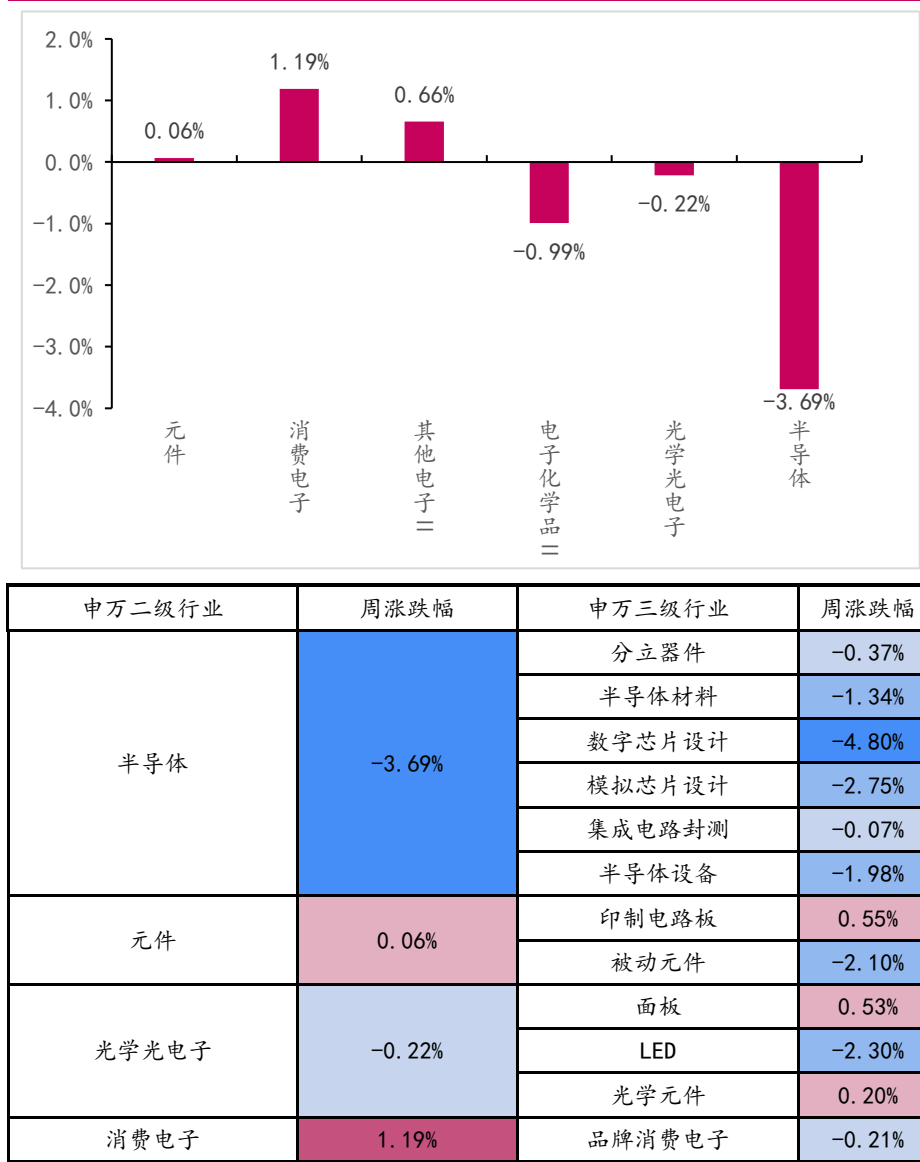
表 2：本周电子板块个股跌幅前五名

证券代码	证券简称	周涨跌幅	收盘价（元）	周最低价（元）	周最高价（元）	周换手率	周成交量（万手）	周成交金额（亿元）
301489. SZ	思泉新材	-20. 89	183. 53	181. 00	256. 00	94. 76	45. 10	94. 57
688691. SH	灿芯股份	-20. 01	116. 78	116. 43	149. 00	82. 16	58. 71	77. 62
688099. SH	晶晨股份	-12. 83	86. 00	86. 00	101. 00	14. 00	58. 97	54. 30
300787. SZ	海能实业	-12. 73	12. 48	12. 41	14. 82	37. 97	72. 50	9. 52
688608. SH	恒玄科技	-12. 31	246. 00	238. 66	288. 00	15. 66	26. 42	68. 07

数据来源：Choice，金元证券研究所

电子行业：本周（2025. 10. 27 - 2025. 10. 31）电子行业整体表现分化明显，板块涨跌互现。从申万二级行业数据来看，消费电子与其他电子表现较强，而半导体板块跌幅居前。消费电子板块上涨1.19%，成为唯一明显上涨的板块，其中消费电子零部件及组装子板块涨幅1.32%，表现亮眼；其他电子板块小幅上涨0.66%，整体保持稳健。元件板块微涨0.06%，涨幅有限，其中印制电路板子板块上涨0.55%，液动元件下跌2.10%。电子化学品板块整体下跌0.99%，子板块表现一致。光学光电子板块微跌0.22%，其中光学元件上涨0.20%，而 LED 子板块下跌2.30%。半导体板块表现最弱，整体下跌3.69%，细分领域中数字芯片设计子板块跌幅最大，达到4.80%，模拟芯片设计与半导体材料亦分别下跌2.75%和1.34%，拖累板块整体表现。总体来看，本周电子行业内部分化显著，消费电子板块延续强势，而半导体与光学光电子板块承压明显，行业整体呈现结构性分化格局。

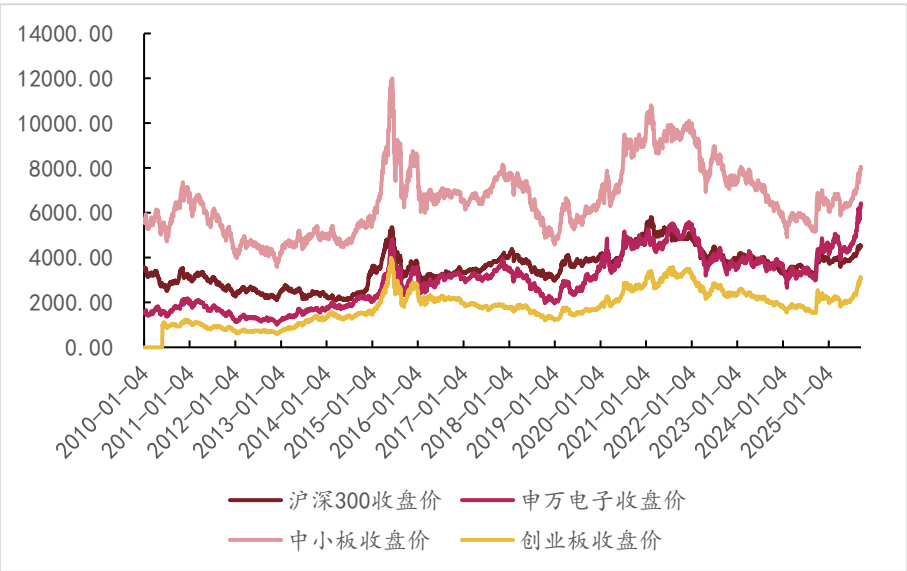
图 5：本周电子版块：子版块涨跌幅



		消费电子零部件及组装	1.32%
电子化学品	-0.99%	电子化学品Ⅲ	-0.99%
其他电子	0.66%	其他电子Ⅲ	0.66%

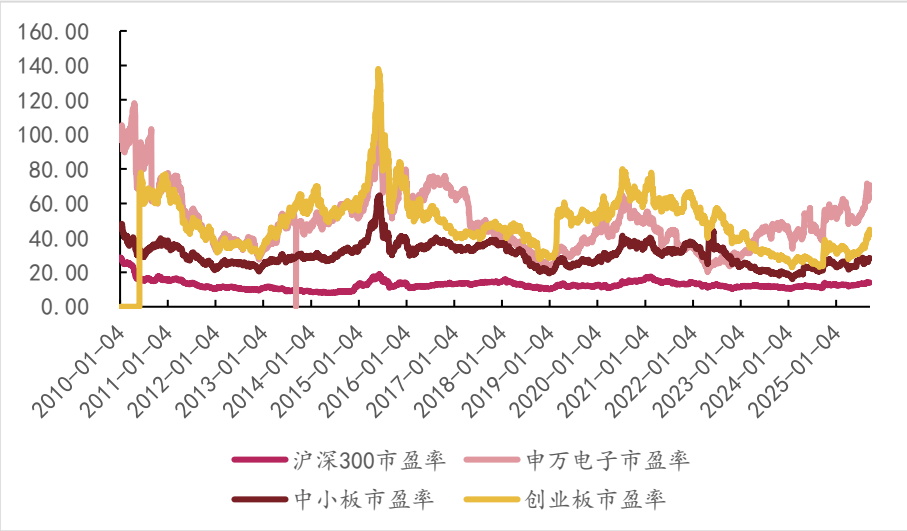
数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 6: 电子板块历史走势



数据来源: Choice, 金元证券研究所

图 7: 电子板块历史市盈率



数据来源: Choice, 金元证券研究所

三、行业新闻

应用材料削减4%人力，因应中美贸易战与营收压力

10月27日据科技新报报道，彭博社消息指出，美国晶片设备龙头应用材料宣布启动全球裁员计画，规模约占员工总数4%，预计影响超过1,400人。公司表

示，此举为强化营运结构与效率，以应对市场波动与地缘政治风险。依据最新申报，应用材料将计入约1.6亿至1.8亿美元费用，主要用于资遣与补偿，大部分支出将于本会计年度第4季入账，并预计于2026会计年度第1季完成。该公司目前拥有约3.61万名员工，为全球最大半导体设备供应商之一。应用材料指出，美国政府近期进一步收紧对中国的出口限制，预估将使公司2026年度营收减少约6亿美元。执行长Gary Dickerson强调，公司正重组以打造更具弹性的组织结构，应对AI晶片与先进制程带来的长期成长机会。分析人士认为，美国出口政策趋严使应用材料、Lam Research及KLA等设备商面临短期压力，但AI与高频宽记忆体需求扩张有望支撑中长期成长。

台积电熊本二厂动工声称主攻6nm制程，2027年底投产

10月27日据爱集微报道，台积电日本子公司JASM正式与菊阳町政府签署熊本二厂建厂合约，标志该厂正式动工。熊本二厂预计于2027年底投产，主攻6nm制程，聚焦AI与自动驾驶应用。厂区位于熊本一厂东侧，占地约6.9万平方米，预计雇用员工约1,700人，与一厂规模相当。JASM社长堀田佑一表示，该项目为重大投资，量产时程将依市场需求调整。台积电对熊本两厂总投资额高达225亿美元，日本经济产业省将提供约77亿美元补助。内阁官房长官木原稔指出，日本将持续强化半导体制造基础与区域供应链。然而，熊本二厂建设曾因交通问题与市场需求疲软延后动工。熊本一厂已于去年底量产22/28nm与12/16nm制程，月产能达5.5万片。二厂采用6nm制程后，将成为日本最先进晶圆厂，并由Sony与丰田集团Denso共同参股，被视为日本重振半导体产业的重要里程碑。

软银批准对OpenAI 剩余225亿美元投资

10月27日据爱集微报道，软银集团宣布批准对OpenAI的剩余225亿美元投资。知情人士透露，此次董事会批准的投资为分期进行，前提是OpenAI需完成企业重组，为未来IPO铺路。这笔资金将用于完成今年4月宣布的410亿美元融资。软银曾于4月中旬投资OpenAI 100亿美元，并计划于12月再注资300亿美元，但追加投资需在OpenAI转型为营利性机构后执行。软银与OpenAI早有合作关系，随着后者技术突破与商业影响力扩大，软银的投资力度持续加码，显示其在AI生态布局的长期战略。

英特尔新AI PC处理器催动换机潮

10月27日据爱集微报道，英特尔上季财报表现亮眼，PC业务恢复成长动能。外界预期，其即将推出的AI PC处理器Intel Core Ultra系列3，代号Panther Lake将于今年稍晚出货，并搭上Windows 10停止更新与AI PC潮流，带动新一波换机热潮。Panther Lake为英特尔首款采用Intel 18A制程的产品，平台算力最高可达180 TOPS，CPU多执行绪性能提升逾五成，GPU效能较前代Lunar Lake提升五成以上。研调机构Gartner指出，全球第三季PC出货量超过6,900万台，年增8.2%，其中AI PC占比预计超过三成。分析认为，随着Panther Lake上市与系统升级需求增长，英特尔有望重新巩固PC处理器霸主地位，并推动华硕、宏碁、广达、鸿海等供应链业者业绩提升。

微软Win11将强化AI功能，迈向AI原生操作系统

10月27日据爱集微报道，微软确认Windows将迈向AI原生平台，打破外界关于“Windows 12”传言。微软副总裁Stefan Kinnestrand表示，Win11未来将成为AI原生操作系统，可实现智能代理功能，让AI直接协助用户执行任务。微软近期推出多项AI互动功能，包括Copilot Voice、Copilot Vision、Copilot Action及Click to Do，逐步取代传统键鼠操作，支持语音与视觉等多模态交互。业界认为，Win11的AI化不仅强化安全性与可扩展性，也将为PC生态带来新一轮系统升级潮，进一步巩固微软在AI操作系统领域的领先地位。

荷兰政府接管安世半导体，传因忧欧洲业务遭拆解

10月29日据科技新报报道，路透社引述四名了解荷兰政府想法的消息人士指出，荷兰政府于9月决定接管晶片制造商安世半导体，主因担忧前执行长计划拆解欧洲业务并将生产转移至中国。消息称，前执行长张学政曾计划裁减40%欧洲人力并关闭慕尼黑研发中心，并在遭荷兰法院于10月1日停职前，将英国曼彻斯特工厂的机密资料转移至母公司闻泰科技在中国的工厂。海牙政府认为此举恐危及欧洲半导体供应安全。安世半导体生产的晶片虽属基础型，却广泛应用于汽车电子系统。9月30日，荷兰政府以公司治理疏失为由正式接管安世；10月4日，中国商务部则禁止安世产品自中国出口。尽管安世多数晶片在欧洲制造，约七成仍需在中国封装后销售。安世中国区现已恢复独立运营并维持国内销售。荷兰方面表示，仍希望透过协商恢复中荷双边合作结构，以避免产业链进一步分裂。

SK海力士M15X厂提前两个月进设备，加速HBM晶片扩产

10月29日据科技新报报道，韩媒TheElec指出，SK海力士已在新建晶圆厂M15X安装首批设备，比原计划提前两个月。该动作被视为加速高频宽记忆体扩产的关键步骤。SK海力士为M15X投资逾20兆韩圆，厂区位于M15附近，主产1b D RAM作为HBM3E核心晶片。消息人士透露，M15X初期月产能3.5万片，未来可扩充至6万片。部分利川厂区员工已调往忠州协助安装与量产准备。M15X具更大无尘室空间，以满足HBM制程对设备与洁净度的高要求。此外，SK海力士同步规划龙仁新厂及美国印第安纳先进封装厂，并于上月宣布完成HBM4开发，准备量产。分析指出，HBM需求强劲将持续推升高阶记忆体投资周期，M15X的提前进展显示海力士力拼AI记忆体市场领先地位。

世芯与光程研创转投资光循科技，宣布两项CPO方案完成初步验证

10月29日据科技新报报道，由光程研创与世芯电子共同投资成立的矽光子新创公司光循科技，宣布以低损耗、高频宽密度的2D阵列面射型光耦合技术为核心，打造新世代光子互连平台，并完成两项CPO技术方案的初步验证。该方案涵盖Micro-LED阵列式高速光通讯模组及搭配CW Laser与高速光波导调变器的光子积体电路平台，均具备高频宽、低功耗及可量产特性。光循科技指出，首款产品预计于2026年第三季推出。根据市场研究，全球矽光子市场正以近30%年复合成长率扩张，将从2025年的26.5亿美元增至2030年的96.5亿美元。公司并延揽前工研院电光系统所方彦翔博士出任营运长，领导团队布局AI资料中心垂直扩展与水平扩充两大应用场景。光循表示，将以整合PDK/ADK设计流程与先进封装为核心，强化台湾在高速光通讯与矽光子产业的国际竞争力。

盛传台积电退休老将罗唯仁将回锅英特尔，掀起半导体市场涟漪

10月29日据科技新报报道，自由时报援引市场消息称，台积电前资深副总经理罗唯仁传出将在退休三个月后重返英特尔担任研发主管，引发产业高度关注。罗唯仁曾任台积电技术研发与企业策略发展副总经理，服务长达21年，主导EUV制程导入及7×24研发中心创建，被视为台积电先进制程关键推手。报导指出，罗唯仁拥有美籍身份，早年亦曾任职英特尔，因此若回锅英特尔将具象征意义。市场人士认为，若消息属实，将有助英特尔提升Intel 18A制程良率，并为美国本土晶圆代工战略提供助力。然而，业界亦有不同看法，认为台积电具备完善的竞业禁止条款，且罗唯仁年事已高、对张忠谋具深厚情感，传闻可信度有限。分析指出，无论结果如何，此事件已凸显英特尔力拼代工业务、吸引台系高层加盟的迫切企图心，也显示美中半导体技术竞争持续升温。

OpenAI Atlas再曝安全漏洞，恶意提示伪装URL可操控AI删除档案

10月29日据科技新报报道，研究机构NeuralTrust最新发现，OpenAI推出的Atlas浏览器存在新的安全漏洞，攻击者可将恶意提示伪装为URL形式发动攻击，使AI错误执行高信任度指令。研究指出，Atlas的多功能输入框会将输入的内容误判为“用户意图”，若用户贴入格式异常的伪装URL，系统可能执行被嵌入的自然语言指令。示例显示，攻击者可诱导用户复制“看似正常”的链接，进而触发AI自动开启钓鱼网站或删除云端文件等破坏性操作。NeuralTrust强调，该漏洞结合社会工程手法，风险高于传统网页注入攻击。其建议OpenAI尽快强化URL解析机制与用户权限隔离，以防止AI代理在高信任环境中执行恶意指令。目前OpenAI尚未对此回应。安全专家指出，此漏洞暴露AI浏览器在人机交互信任机制中的潜在弱点，提醒业界需更严谨区分“命令”与“意图”。

强化布局半导体制程，台达砸50亿日圆收购射频电源系统商NRF

10月30日据科技新报报道，台达电子公告以约50.24亿日圆，通过子公司Delta Electronics B.V.收购日本Noda RF Technologies的90.23%股权，加上原持股，交易完成后将全资持有NRF；本案仍待主管机关核准。NRF为半导体核心制程提供关键射频电源系统，广泛应用于蚀刻、CVD、PVD等环节，并延伸至面板制造。台达董事长暨执行长郑平表示，双方技术互补可强化产品组合并提升研发与业务综效；NRF社长野田和利称，借助台达全球布局与制造能力，将为半导体客户创造更大价值。

AWS加码投资韩国50亿美元，扩建AI资料中心

10月30日据科技新报报道，AWS宣布于2025至2031年在韩国追加约50亿美元投资于AI资料中心，使在地累计投资上看90亿美元，成为当地云服务最大绿地项目之一。新资料中心将设于仁川与京畿道，并与今年6月携手SK集团推动、预计2027年启用的乌山AI专区相互呼应，首阶段目标100MW、长远规划达1GW。AWS亚太区总经理Jaime Valles称，此举展现将韩国打造为全球AI重镇的长期承诺；AWS亦将以Trainium、Inferentia等专用硬体支持企业上云。韩国总统李在明表示，投资将强化“AI高速公路”建设。AWS自2017年来已培训逾30万名云端人才；该计划为AWS在亚太14国、总额约400亿美元投资的一环，预期带动逾450亿美元经济效益。

辉达Vera Rubin超级晶片GTC亮相，搭载HBM4性能提升三倍

10月30日据科技新报报道，NVIDIA在华盛顿举办的GTC October 2025首度公开次世代Vera Rubin Superchip：主板整合一颗Vera CPU与两颗Rubin GPU，提供最多32个LPDDR插槽与HBM4配置。Rubin GPU为台积电代工样品，具8个HBM4介面与“双Reticle尺寸”核心；Vera CPU采用88个客制化Arm核心、176执行绪。官方规划Rubin GPU于2026年第三至第四季量产。新NVL144平台以两颗Rubin GPU与Vera CPU组成，宣称FP4推理3.6 Exaflops、FP8训练1.2 Exaflops，较GB300 NVL72约3.3倍，并具13TB/s系统记忆体频宽、75TB快取储存、双倍NVLINK与CX9传输。NVIDIA并规划2027年下半年推出Rubin Ultra NVL576平台，目标FP4推理15 Exaflops、FP8训练5 Exaflops与1TB HBM4e。

挑战台积电、ASML，美新创推X光曝光技术，欲颠覆高价EUV制造

10月30日据科技新报报道，美国新创Substrate宣布开发X光曝光设备，声称以更短波长与粒子加速器光源实现与ASML最先进EUV相当的解析度，并以更低设备成本降低晶片制造门槛。执行长James Proud表示，公司目标在美国自建晶圆代工与台积电竞争，并于2028年前量产；其法人与Founders Fund、General Catalyst、Valor Equity等已投资逾1亿美元、估值上看十亿美元。分析指，若能显著降本，或引发产业级连效应；但先进制程量产需巨额资本与深厚制程Know-how，技术、良率与规模化仍面临高挑战。

迈荪科技预计11月底挂牌上市，携手英特尔卡位AI伺服器散热

10月30日据科技新报报道，迈荪科技将在明日举行上市前法说明会，预估11月底挂牌。董事长赵元山表示，受CSP导入新晶片与AI建置需求带动，液冷占比自10%起步向上，越南厂投产将增20%产能；今年前9月营收27.63亿元、年增86.86%，并已超越去年全年。公司以均温板气冷量产起家，现布局液冷并与英特尔成立“先进散热技术联合实验室”。总经理林俊宏称，AI伺服器散热营收占比逾五成，已开发第二代增强型3DVC与浸没式水冷，并推进超流体CDU与高功率水冷头，产品导入国际CSP；相关新晶片预计2026年第二季量产。法人认为AI伺服器散热单价为传统3倍以上，有助毛利与获利结构优化，水冷与3DVC应用版图可望持续扩大。

三大记忆体厂财报齐报捷，WSJ声称AI引爆记忆体进入超级繁荣期

10月31日据科技新报报道，华尔街日报称在NVIDIA、OpenAI等AI需求带动下，记忆体产业迈入长期超级繁荣期。TrendForce预估明年DRAM产业营收可望达2,310亿美元、较2023年低谷逾4倍。财报面向，三星第三季净利年增21%且记忆体部门创高；SK海力士净利翻倍并称至明年产能已售罄；美光单季净利达32亿美元、年增逾三倍。WSTS统计记忆体约占全球晶片销售四分之一。报导并指OpenAI与三星、SK海力士签意向书纳入Stargate计划；SK海力士估OpenAI每月DRAM需求可达90万片，超出当前HBM产业产能两倍。除HBM外，传统伺服器记忆体需求同样火热且可用于AI推论。TrendForce并预期HBM市场5年均增逾30%，整体供应紧俏恐延续至2026年、甚至2027年初。

CSP主权云需求热络，2026年AI伺服器出货估年增逾20%

10月31日据科技新报报道，TrendForce最新分析指出，受CSP与主权云稳健拉

货及AI推理应用扩张带动，2026年全球AI伺服器出货量年增可逾20%，占整体伺服器比重升至17%。2025年受H20在中国受阻与GB300/B300进度延后，年增率微降至约24%；但因Blackwell新平台与GB200/GB300整柜方案价值高，2025年AI伺服器产值可年增近48%。2026年GPU厂商推动整柜方案、CSP加码ASIC，产值有望再增逾30%，营收占比达74%。市占方面，2025年NVIDIA约70%，至2026年随北美CSP与中国自研ASIC加速，NVIDIA占比下滑。HBM需求方面，2025年年增估达130%，2026年续增约70%；HBM3e价格2025年年涨5%~10%，2026年随三大原厂竞争恐转年减；HBM4进入送样且2026年ASP高于HBM3e、供应商获利空间更大。

崑崙11月底挂牌上柜抢进AI伺服器，越南二厂明年第三季量产

10月31日据科技新报报道，崑崙精密将于明日举行上柜前业绩发表会、预定11月底挂牌。董事长姚旭初表示，受AI与云端数据中心对精密机构件强劲需求带动，营运审慎乐观；越南二厂预计明年第三季底量产，整体越南产能可望倍增。公司专注精密注塑、冲压、CNC、压铸与整合组装等「一站式服务」，客户以美系云端大厂为主，云端应用营收占比约7~8成。目前海外据点以东莞与越南北宁为主，现有产能比约中70%/越30%，新厂投产后将优化至中40%/越60%。财务面，2024年税后纯益3亿元、EPS 10.72元；2025年上半年营收10.64亿元、毛利率39%、税后纯益2.07亿元，前9月营收17.28亿元已超越去年全年。

日月光投控再增资本支出，明年先进封装营收看涨

10月31日据科技新报报道，日月光投控财务长董宏思表示，第四季合并营收以新台币计季增1%~2%，毛利率与营益率各季增0.7至1个百分点；封装事业季增3%~5%、毛利率季增1至1.5个百分点。公司今年美元计价封装业绩年增逾20%，先进封装与测试营收可达16亿美元目标；测试营收成长幅度可超越封装两倍。为因应2026年强劲需求，今年将再增数十亿美元资本支出，全年CAPEX料逾60亿美元，涵盖设备、厂房与设施扩建。展望2026年，AI与HPC将持续推升先进封装与测试动能，先进封装营收有望再增10亿美元；晶圆测试与成品测试产能均将扩充。

OpenAI明星工程师Will DePue重返公司成立新团队，聚焦人工超智慧

10月31日据科技新报报道，OpenAI工程师Will DePue宣布重返公司，成立精简新团队，聚焦人工超智慧研究，并与Sora开发成员Troy与Eric Luhman合作。DePue称团队目标是「高风险的大赌注」，虽成功机率不高但可能带来突破；现开放对前沿领域有志者加入。公开资讯显示，DePue曾就读密西根大学资工系、2023年加入OpenAI并参与ChatGPT训练与Sora开发；其个人网站亦列出多项实验性专案。OpenAI尚未披露团队细节。此前OpenAI在6月推出o3与o4-mini模型，整合网搜、Python分析、视觉推理与产图等工具，被视为ChatGPT在推理与实用性上的新里程碑。

四、公司公告

影石创新：2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一批次的公告
公司10月27日发布公告，称根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》及2025年第二次临时股东大会授权，董事会审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票（第一批次）的议案》，确定以2025年10月27日为预留授予日，以148.92元/股价格向3名激励对象授予5.0866万股限制性股票，占公司总股本40,100万股的约0.01%。本次授予方式为第二类限制性股票，相关授予条件均已成就，符合公司激励计划及监管要求。公司表示，本次预留授予旨在进一步完善激励机制，增强核心团队稳定性和积极性，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

国瓷材料：对外投资购买股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告
公司10月27日发布公告，山东国瓷功能材料股份有限公司近日与未名磐石投资管理（北京）有限公司签署《份额转让协议》，并与其他合伙人签订《合伙协议》，拟以自有资金约2,000万元人民币受让其持有的“北京管营未名”股权投资基金企业37.52%份额。交易完成后，公司将取得相应投资权益。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易已获公司董事会及股东大会审议批准。公司表示，本次投资为与专业投资机构共同合作，符合公司战略发展规划，不会对公司财务状况、控制权及持续经营产生重大影响。

乐鑫科技：2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告
公司10月27日发布公告，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定，拟向激励对象预留授予限制性股票。公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定以2025年10月27日为预留授予日，以120.29元/股授予价格向22名激励对象授予71,808股限制性股票，占公司总股本167,143,010股的0.0430%。公司表示，本次预留授予条件已成就，符合相关法规及激励计划规定，有助于进一步完善公司长效激励机制，激发核心员工积极性，对公司治理结构及持续经营无重大影响。

蓝特光学：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

公司10月27日发布公告，浙江蓝特光学股份有限公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于作废历年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。此次作废系因部分员工个人原因离职或不再具备激励对象资格。根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》及相关管理办法，本次作废数量为12万股。公司表示，本次作废事项符合既定激励计划条款及相关法律法规要求，不会影响公司股权结构及持续经营稳定。

奥海科技：关于2025年前三季度利润分配方案的公告

公司10月27日发布公告，东莞市奥海科技股份有限公司披露2025年前三季度

利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计分配现金人民币1.63亿元。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。公司表示，2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为3.59亿元，母公司可供分配利润为2.11亿元。利润分配以截至公告披露日公司总股本2.76亿股，扣除回购专户股份后2.72亿股为基数计算。公司强调，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。如在实施前享有分红权的股本总额发生变动，将按照每股分配金额不变原则对总额进行相应调整。

领益智造：关于2025年半年度权益分派实施的公告

公司10月27日发布公告，广东领益智造股份有限公司披露2025年半年度权益分派实施方案，以实施权益分派股权登记日的总股本7,306,060,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金人民币1.45亿元。本次利润分配不送红股、不以资本公积金转增股本。公司表示，回购专用证券账户中的股份8,231,900股不享有利润分配权，不参与本次分派。以扣除回购股份后的总股本7,267,829,077股计算，每股派现金红利约0.0198953元（含税）。本次分红方案已获公司2025年半年度股东大会审议通过，并将在登记日后正式实施。

四会富仕：控股股东及一致行动人被动稀释暨减持触及1%整数倍提示性公告

公司10月28日发布公告，四会富仕电子科技有限公司控股股东四会市明诚贸易有限公司及其一致行动人因“富仕转债”转股导致总股本增加，同时于10月21日至27日期间累计减持公司股份130.88万股，合并影响下持股比例由58.9222%降至57.2532%，权益变动触及1%整数倍。本次变动系转股扩股与减持叠加所致，符合此前披露的减持计划安排，不会导致控股股东及其一致行动人发生变化，对公司治理结构及持续经营无重大影响。

北京君正：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告

公司10月28日发布公告，北京君正集成电路股份有限公司股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业于2025年3月4日至10月27日期间，通过集中竞价方式累计减持公司474.75万股。此前该股东曾于2025年6月办理增发970,812股的股份登记，导致公司总股本变动。减持完成后，武岳峰集电持股比例下降并触及1%整数倍。本次减持系股东根据自身资金安排进行，不会导致公司控制权变更，也不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

世运电路：关于2025年中期利润分配方案的公告

公司10月28日发布公告，广东世运电路科技股份有限公司董事会审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》。公司拟以截至2025年9月30日的总股本720,592,317股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计拟派发红利216,177,695.10元（含税），占公司截至期末母公司报表中归属于上市公司股东净利润的比例约34.58%。公司不进行资本公积金转增股本或送红股。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

深圳华强：关于2025年第三季度利润分配预案的公告

公司10月28日发布公告，深圳华强实业股份有限公司于2025年10月27日召开董事会及监事会会议，审议通过《2025年第三季度利润分配预案》。公司拟以合并报表归属于母公司股东的净利润3.61亿元为基数，结合年初未分配利润9.54亿元，减去已分配红利约2.49亿元后，可供分配利润为12.54亿元。公司表示，综合考虑经营业绩表现、未来发展资金需求及股东回报，拟将该方案提交股东大会审议。

豪威集团：关于2025年中期利润分配方案的公告

公司10月28日发布公告，豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》。公司拟以截至2025年9月30日的总股本1,206,382,412股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计拟派发现金红利480,984,496.00元（含税），占公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例约14.89%。公司不进行资本公积金转增股本或送红股。本次利润分配方案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

澜起科技：关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告

公司10月28日发布公告，澜起科技股份有限公司股东中国电子投资控股有限公司与嘉兴芯电投资合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式减持公司股份，合计持股比例由5.118%降至4.9999%，不再为公司持股5%以上的股东。本次权益变动系前期已披露的减持计划正常执行，不涉及资金来源或约定收购安排。公司表示，本次权益变动不会导致公司控制权变更，对公司治理结构及持续经营无重大影响。

逸豪新材：持股5%以上股东减持触及1%整数倍暨持股降至5%以下的公告

公司10月29日发布公告，赣州逸豪新材料股份有限公司持股5%以上股东赣州逸源股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过集中竞价方式减持公司股份91.18万股，占公司总股本比例约5.3932%。减持后，其持股降至84.53万股，占公司总股本比例约4.9999%，不再为持股5%以上的股东。公司表示，本次减持系依据此前披露的计划执行，不涉及资金来源或协议收购安排，亦不会导致控股股东及实控人发生变化，对公司治理结构及持续经营无重大影响。

思特威：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

公司10月29日发布公告，思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，拟以截至公告披露日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股。本次分配方案依据公司良好的经营状况及稳健的现金流制定，尚需提交公司股东大会审议通过后实施。公司表示，本次利润分配方案旨在回报股东，不会对公司正常生产经营造成不利影响。

四会富仕：关于控股股东及其一致行动人被动稀释暨股份减持触及1%整数倍的提示性公告

公司10月29日发布公告，四会富仕电子科技股份有限公司控股股东四会市明诚贸易有限公司及其一致行动人四会天诚创业投资合伙企业（有限合伙）因

可转债转股及部分股份减持，合计持股比例由57.2532%降至56.6127%，权益变动触及1%整数倍。本次变动系公司可转债转股导致股本扩大及股东主动减持共同作用所致，不会导致公司控制权变化，对公司治理结构及持续经营无重大影响。

好利科技：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

公司10月29日发布公告，好利科技（中国）电子科技股份有限公司董事会审议通过《2025年前三季度利润分配预案》。公司拟以截至公告披露日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股。根据财务数据，公司2025年前三季度实现归母净利润38,991.41万元，期末可供分配利润约40,495.27万元。公司表示，本次利润分配方案符合持续稳定分红原则，旨在回馈股东，方案尚需提交股东大会审议。

世华科技：2025年前三季度利润分配方案公告

公司10月29日发布公告，苏州世华新材料科技股份有限公司董事会审议通过《2025年前三季度利润分配方案》，拟以截至公告披露日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行资本公积转增股本或送红股。公司2025年前三季度实现归母净利润3.16亿元，期末可供分配利润约1.81亿元。本次分红方案体现公司稳定回报股东的政策，尚需股东大会审议通过后实施。

博通集成：关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的公告

公司10月30日发布公告，博通集成电路（上海）股份有限公司董事会审议通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。公司将依据《上市公司募集资金管理办法》及相关法规要求，为提高募集资金管理效率并确保募集资金专款专用，拟开立募集资金专户并签署监管协议，用于“边缘AI处理器产品及解决方案研发项目”募集资金存储及使用。公司授权财务部门及管理层负责办理相关开户及协议签署事项。募集资金专户中的资金仅限用于项目建设支出，不得挪作他用，公司将依据项目进展及时履行信息披露义务。

立讯精密：关于2025年前三季度利润分配预案的公告

公司10月30日发布公告，立讯精密工业股份有限公司董事会审议通过《2025年前三季度利润分配预案》，拟以截至公告披露日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计拟派发现金股利人民币11.65亿元。本次利润分配方案依据公司2025年前三季度实现归母净利润约95.69亿元、可分配利润充足的情况制定，旨在回报股东、增强投资者信心，方案尚需提交股东大会审议。

兴福电子：关于开立募集资金补流专项账户并签订监管协议的公告

公司10月31日发布公告，湖北兴福电子材料股份有限公司董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金专项账户并签订募集资金临时补充流动资金专项账户监管协议的议案》。公司依据《上市公司募集资金管理办法》及相关监管要求，为提高募集资金使用效率和资金管理水平，决定开

立专项账户并签署监管协议，用于存放及管理临时补充流动资金。公司表示，该专项账户仅限募集资金用途范围内使用，不得挪作他用，公司将根据项目实施进度及时披露资金使用及监管情况。

五、下周重要事件提示

表 3：下周重要会议

行业会议				
序号	会议名称	会议时间	会议地点	主办单位
1	2025 消费电子创新大会	11.6-11.8	深圳市	河套“6+1”国际产业与标准组织
2	2025 区块链和 Web3.0 技术创新与应用交流大会	11.7-11.9	成都市	中国电子学会、电子科技大学
3	AESG 2025 电子特气与半导体前驱体论坛	11.5 - 11.6	苏州市	亚化咨询
公司会议				
序号	公司名称	会议名称	会议时间	
1	实益达	股东大会举办	2025-10-31	
2	艾比森	股东大会举办	2025-10-31	
3	长信科技	股东大会举办	2025-10-31	
4	经纬辉开	股东大会举办	2025-10-31	
5	胜蓝股份	股东大会举办	2025-10-31	
6	协创数据	股东大会举办	2025-10-31	
7	宏昌电子	股东大会举办	2025-10-31	
8	芯原股份	股东大会举办	2025-10-30	
9	朝阳科技	股东大会举办	2025-10-30	
10	光莆股份	股东大会举办	2025-10-30	
11	东山精密	股东大会举办	2025-10-30	
12	茂硕电源	股东大会举办	2025-10-30	
13	汇顶科技	股东大会举办	2025-10-30	
14	ST 东尼	股东大会举办	2025-10-29	
15	晶合集成	股东大会举办	2025-10-29	
16	银河微电	股东大会举办	2025-10-29	
17	龙图光罩	股东大会举办	2025-10-29	

数据来源：Choice，金元证券研究所

表 4：电子行业限售股解禁情况汇总（单位：万股）

股票代码	公司名称	解禁日期	解禁数量	总股本	解禁前		解禁后		解禁股份类型
					流通 A 股	占比 (%)	流通 A 股	占比 (%)	
002959.SZ	小熊电器	2025-11-03	3.30	15,728.80	15,194.98	96.61	15,198.28	96.63	股权激励限售股份
301230.SZ	泓博医药	2025-11-03	6,272.63	13,958.66	7,686.03	55.06	12,561.58	89.99	首发原股东限售股份
301050.SZ	雷电微力	2025-11-03	242.04	24,479.18	20,794.53	84.95	21,036.57	85.94	股权激励一般股份
920149.BJ	旭杰科技	2025-11-03	95.81	7,597.37	6,190.42	81.48	6,273.85	82.58	股权激励期权行权
000153.SZ	丰原药业	2025-11-03	824.25	46,477.37	45,231.37	97.32	46,055.62	99.09	股权激励限售股份
000409.SZ	云鼎科技	2025-11-03	15,327.93	67,799.05	42,334.32	62.44	57,662.26	85.05	定向增发机构配售股份
301129.SZ	瑞纳智能	2025-11-03	8,899.20	13,591.74	3,736.55	27.49	6,628.25	48.77	追加承诺限售股份上市流通
002864.SZ	盘龙药业	2025-11-04	28.16	10,628.10	7,419.07	69.81	7,447.23	70.07	股权激励限售股份
300681.SZ	英搏尔	2025-11-04	315.34	26,295.85	18,391.43	69.94	18,706.77	71.14	股权激励一般股份
920046.BJ	亿能电力	2025-11-04	4,792.10	10,115.00	5,143.87	50.85	6,407.73	63.35	公开发行原股东限售股份
301628.SZ	强达电路	2025-11-04	242.91	7,537.58	3,019.47	40.06	3,262.38	43.28	首发原股东限售股份
920396.BJ	常辅股份	2025-11-04	24.48	7,197.63	5,081.22	70.60	5,087.34	70.68	股权激励期权行权
688726.SH	拉普拉斯	2025-11-04	16.88	40,532.62	4,536.57	11.19	4,553.45	11.23	首发原股东限售股份
688521.SH	芯原股份	2025-11-04	14.50	52,585.83	50,085.28	95.24	50,099.78	95.27	股权激励一般股份
301367.SZ	瑞迈特	2025-11-04	3,281.07	8,960.00	5,643.66	62.99	6,994.36	78.06	首发原股东限售股份
688228.SH	开普云	2025-11-04	3.25	6,751.82	6,751.82	100.00	6,755.08	100.05	股权激励一般股份
688372.SH	伟测科技	2025-11-04	10.94	14,894.42	14,894.42	100.00	14,905.36	100.07	股权激励一般股份
688003.SH	天准科技	2025-11-05	18.40	19,432.05	19,413.65	99.91	19,432.05	100.00	股权激励一般股份
605488.SH	福莱新材	2025-11-05	4.20	28,021.87	27,614.99	98.55	27,619.19	98.56	股权激励限售股份
688717.SH	艾罗	2025-	70.83	16,000.00	9,713.95	60.71	9,784.78	61.15	追加承诺限售股份上市流

	能源	11-05							通, 首发原股东限售股份
002340. SZ	格林美	2025-11-05	322.18	512,429.91	508,595.25	99.25	508,917.43	99.31	股权激励限售股份
605319. SH	无锡振华	2025-11-05	53.90	35,008.62	30,056.12	85.85	30,110.02	86.01	股权激励限售股份
600415. SH	小商品城	2025-11-05	69.87	548,355.92	548,286.05	99.99	548,355.92	100.00	股权激励限售股份
300015. SZ	爱尔眼科	2025-11-05	624.15	932,539.67	793,095.92	85.05	793,720.07	85.11	股权激励限售股份
920992. BJ	中科美菱	2025-11-06	1,950.00	9,673.09	2,789.82	28.84	4,739.82	49.00	追加承诺限售股份上市流通
688036. SH	传音控股	2025-11-06	1,083.40	115,118.45	114,035.06	99.06	115,118.45	100.00	股权激励一般股份
601990. SH	南京证券	2025-11-06	2,657.22	368,636.10	365,978.88	99.28	368,636.10	100.00	定向增发机构配售股份
300348. SZ	长亮科技	2025-11-07	67.71	81,103.82	70,849.28	87.36	70,916.99	87.44	股权激励限售股份
920871. BJ	派特爾	2025-11-07	154.97	8,498.56	4,412.87	51.92	4,567.84	53.75	股权激励限售股份
603486. SH	科沃斯	2025-11-07	152.34	57,903.31	57,187.83	98.76	57,340.17	99.03	股权激励限售股份
301633. SZ	港迪技术	2025-11-07	1,176.00	5,568.00	1,392.00	25.00	2,568.00	46.12	首发原股东限售股份
002209. SZ	达意隆	2025-11-07	8.40	19,902.91	15,640.38	78.58	15,648.78	78.63	股权激励限售股份
301267. SZ	华厦眼科	2025-11-07	51,117.00	84,000.00	32,882.89	39.15	83,999.89	100.00	首发原股东限售股份
605116. SH	奥锐特	2025-11-07	206.60	40,619.52	40,411.72	99.49	40,618.32	100.00	股权激励限售股份

数据来源: Choice, 金元证券研究所

金元证券行业投资评级标准：

增持：行业股票指数在未来 6 个月内超越大盘；

中性：行业股票指数在未来 6 个月内基本与大盘持平；

减持：行业股票指数在未来 6 个月内明显弱于大盘。

金元证券股票投资评级标准：

买入：股票价格在未来 6 个月内超越大盘 15%以上；

增持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为 5%~15%；

中性：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~+5%；

减持：股票价格在未来 6 个月内相对大盘变动幅度为-5%~-15%；。

免责声明

本报告由金元证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告所载资料的来源及观点的出处皆被金元证券认为可靠，但金元证券不保证其准确性或完整性。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，金元证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。投资者需自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告所载的信息、材料或分析工具仅提供给阁下作参考用，不是也不应被视为出售、购买或认购证券或其他金融工具的要约或要约邀请。该等信息、材料及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，金元证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

金元证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。金元证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。金元证券的自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

在法律许可的情况下，金元证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到金元证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

本报告的版权仅为金元证券所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。